第 159 回　CiecAP 運営委員会　国際会議出席報告

2006 年 12 月度

資料 No.	＜ＴＣ４７関係＞国際会議報告書
159-3／TC47-①	TC47「半導体デバイス 」ロンドン会議報告書　2006.10.22ー20061027
159-3／TC47-②	TC47「半導体ベアダイプロジェクト 」ロンドン会議席報告書　2006.10.23
資料 No.	＜ＳＣ４７Ａ関係＞国際会議報告書
159-3／SC47A-①	SC47A/WG9「集積回路／EMC 測定方法」ロンドン会議報告書 20061025－20061026
159-3／SC47A-②	SC47A/WG2「集積回路／デジタル IC」ロンドン会議報告書 20061023－20061024
159-3／SC47A-③	SC47A「集積回路」ロンドン会議報告書 20061023－20061027
資料 No.	＜ＳＣ４７Ｅ関係＞国際会議報告書
159-3／SC47E-①	SC47E/WGs「個別半導体／半導体センサー、他」ロンドン会議報告書 20061023－20061027
資料 No.	＜ＳＣ６２Ｄ関係＞国際会議報告書
159-3／SC62D-①	SC62D/MT16「医用光学機器」フランクフルト会議報告書 20061112－20061115
159-3／SC62D-②	SC62D/JWG7「自動式非観血血圧計」リマソール会議報告書 20061105－20061108
資料 No.	＜ＴＣ９１関係＞国際会議報告書
159-3／TC91-①	TC91/WG1　「電子実装技術」　ロンドン会議報告書 20061024
159-3／TC91-②	TC91/WG2　「電子実装技術／信頼性試験方法」ロンドン会議報告書 061024-20061025
159-3／TC91-③	TC91/WG3　「電子実装技術／試験方法」ロンドン会議報告書 20061024-20061025
159-3／TC91-④	TC91/WG12「電子実装技術」ロンドン国際会議報告 20061023
159-3／TC91-⑤	TC91/WG3&TC47/WG2「電子実装技術＆半導体信頼性試験方法との JWG」ロンドン会議報告書 20061026-20061026
159-3／TC91-⑥	TC91/WG1/62462Ed.1「電子実装技術／表示」ロンドン国際会議報告書 20061023-20061026
159-3／TC91-⑦	IEC/TC91 Plenary「電子実装技術／総会」 ロンドン国際会議報告書　20061027

様式 4

（社）電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会　御中

運営委員会・資料番号：159-3/TC47-①（事務局記入）

提出日：2006 年 11 月 29 日

（報告者記載）整理番号：H18TC47③

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：田中政樹　報告書作成者氏名：若井伸之　（会社名）東芝

出席会議名（半角）	区分	組織番号（TC/SC/TA）	TC47（半角）
TC47	☒TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他		
TC47WG2	☐TC ☐SC ☐TA ☒WG ☐PT ☐その他	名称（日本語）	半導体デバイス
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	☐単独開催	☒同時開催
開催期日	2006 年 10 月 22 日 ～ 2006 年 10 月 27 日		
開催場所	（国名）英国	（都市名）ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	TC47-米国 TC47WG2-英国	幹事国　韓国	
参加国及び参加人数	7ヶ国、主な国名 英国、独、仏、米国、韓国、中国、日、参加人数（37）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者…（例）：○ 電子太郎（JEITA 電子）] ○若井伸之（東芝）　永広祐一（東芝）		

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。）

TC47：

冒頭に、ルール改正(Circulation の時短：2ndCDV 後 5→2 ヶ月、SMB6→4 ヶ月)の内容が説明され、席上承認された。TC をまたがるケースの問題点(TC91(実装),TC101(静電気),TC111(環境規格)、TC86(オプトデバイス)等)があげられ、TC91 との件は WG2 コンビナ預かりで進めていくことを確認。各 WG と PT の Status がコンビナ(or 代理)から紹介された。会議が実施されなかった WG5 はコンビナに代わり若井委員が報告し、日本から提案している 3 文書の状況を承認いただいた。ただし、4 規格が PWI になっている事の指摘を受け、WG 内での再開討議が必須となった。WG2 および PT62258 は特に問題なく了承された。標準化済みの各文書のメンテナンススケジュール(2007 年以降から順次実施)の確認を行った。(次回 TC47 は仏で開催)

TC47WG2：1.落下試験,2.CDM,3.ESD,4.半田耐熱,5.SER の規格化状況について討議実施。

1.落下試験：日本から要求していた歪みゲージ法の規格への取り込みは、スコープ記載内容にて US(JEDEC 規格準拠)起案内容との使い分け示し、個々の規格にて進めていく方針が提案された。NP 提案から進める事になるが、IEC 側の不備で審議が非効率になった背景もあり、効率的な標準化ワークの確認依頼をした。

2.CDM は Direct-Contact(DC)と Field-Induced(FI)の 2 手法内容の共存する内容の検討を前回までに続けてきたが、内容の共有化が厳しい状況にあり、個別に標準化を進める事が提案された。内容的に日本が提案していた DC 法を日本側で標準化作業の要請がコンビナから出された。WG 内で詳細データ確認後、実ワーク内容の検討を進める。

3.ESD は HBM と MM の改訂作業を開始する事をコンビナーから提案され、日本側が両規格とも進める旨了解された。特に現 Ed.2.0 で反映されなかった日本から提案していた技術的なコメントを反映させた内容を提案していく事も了解されており、これらのワークを進めていく。

4.半田耐熱は、Pb フリー条件の半田のピーク温度(～260℃)の追加および吸湿条件の変更案を US から出された。コンビナーが内容をまとめて各国で事前確認を進めていくこととした。

5.SER は中性子線照射試験方法について規格進めることが承認され、日本にて EDR4705 をベースにドラフトの作成を進めていく事コンビナーから了解された。　TC91/WG3 とのジョイント会議にも参加し、落下試験等のワーク内容のシェアを行った。

※上記に加え、TC91/WG3 とのジョイントミーティングも行われ、落下試験をはじめとする双方の標準化作業の内容確認を行った。　次回 2007 年 6 月(IEC@シンガポール：TC91 とのジョイント含)、2007 年 11 月仏で行う。

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

IEC 活動推進委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　標準化センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（(三井住友海上別館ビル)　Tel:03-3518-6435　Fax:03-3295-8727

様式 4

（社）電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会　御中

運営委員会・資料番号：159-3/TC47-②-（事務局記入）

提出日：2006 年 11 月 30 日

（報告者記載）整理番号：H18TC47⑦

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：田中政樹　報告書作成者氏名：永広祐一　（会社名）（株）東芝

出席会議名（半角）	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC47/PT62258（半角）
TC47PT62258	□TC □SC □TA □WG ☒PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称 (日本語)	半導体ベアダイプロジェクト
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	□単独開催	☒同時開催
開催期日	2006 年 10 月 23 日 ～ 2006 年 10 月 27 日		
開催場所	（国名）イギリス	（都市名）ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	J.Walbert（米国）	幹事国　米国	
参加国及び参加人数	4ヶ国、主な国名 米国、英国、中国、日本、参加人数（8）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者…（例）：○ 電子太郎（JEITA 電子）] ○永広祐一（東芝）		

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは１行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。）

１．背景：　ベアダイに関するＩＥＣ規格を作成するプロジェクトチームが２００１年１月に承認され、欧州のベアダイ仕様ＥＳ５９００８をベースに米国／日本の意見を取り入れる形で国際版ドラフトを作成中である。

２．目的：　規格の目的はベアダイを調達する際にダイサプライヤーとダイユーザーの間でデーターをどのような形式で交換するかを示したもので、最低要求事項を定義。規格の構成は８つのパートに分かれ、パート１．(ﾍﾞｱﾀﾞｲ)調達と使用のための必要条件、２．取り交わしのデーター形式、３．(半導体チップの)取扱い／包装／保存の上手な実践のための推奨条件、４．ベアダ使用者と供給者の(間の)質問調査表、５／６．電気的／熱的シミュレーションに関しての(入力)情報の必要条件、７．ﾃﾞｰﾀ-交換の XML-schema、８．ﾃﾞｰﾀ-交換の Express-schema で構成されている。

３．今回の議題：パート８のチームドラフト作成と、パート１，２，３の改訂作業を行った。

（特記）；今回より中国も参加したいとの申し出が有り、３名参加した。まだ様子見であり、今後、中国から欧州チームとは一線を描くような意見が出てくることも期待される。

４．成果：　まず、新規事項としてパート８（Express model schema）のチームドラフトを作成した。パート８はＴＲとして独立はしているものの、その内容は基本的にパート７と同じ。要求事項として定義される項目はパート７と同じで、使用する言語（ソフトのモデル）が違っている。よって、今回の審議は、必要とされる情報内容やその定義というよりも Express フォーマットに沿った（標準としての）表現調整がメイン。この会議でＤＴＲとしてのパート８の準備が完了した。パート１，２，３については、すでに標準もしくはＴＲとして発行済。今回はそれらがメンテナンスサイクルに入ったため、改訂作業を行った。最近、発行もしくはＣＤＶとなった６２２５８の後半部のパート４～７（含む８）と、前半部のパート１～３を比較し、パート１～８まで通したときに、一貫した標準であることを容易に理解できるよう見やすくし、新用語も追加した。

５．問題点その他：　技術的なもの、要求事項と定義については、前回会議でほぼど詰められており、今回の審議において新たな問題はないものと思われる。またベアダイ標準として、どこまでがベアダイとして取り扱うかの定義について、今回チーム内で再確認をした。この標準では minimally-package die(MPD)までをベアダイとしているが、それは、ダイの簡単な保護とダイの取り扱いが容易であるＣＳＰ(Chip sacale package)までがこの標準の規定範囲であるとの認識で全員一致した。（ＣＳＰは半分ベアダイと考えられ、取り扱い／組立／保存環境についてはベアダイ並の扱い。）

６．今後の予定：２００７年１月１５、１６日　ベルギー（ブリュッセル　ＣＥＮＥＬＥＣ本部）
２００７年６月×日　イギリス（ポーツマス）、２００７年１１月６日　フランス（トォールース

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

IEC 活動推進委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会　標準化センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（(三井住友海上別館ビル)　Tel:03-3518-6435　Fax:03-3295-8727

様式 4

（社）電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会　御中

運営委員会・資料番号：**159-3/SC47A-①**（事務局記入）

提出日：2006 年 11 月 1 日

（報告者記載）整理番号：H18SC47A③

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：中村 篤　報告書作成者氏名：齊藤 義行　（会社名）松下電器産業（株）

出席会議名（半角）	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC47A/WG9（半角）
SC47A / WG9	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称（日本語）	集積回路／EMC 測定方法
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	□単独開催	☒同時開催
開催期日	2006 年 10 月 25 日 ～ 2006 年 10 月 26 日		
開催場所	（国名）イギリス	（都市名）ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	Mart Coenen	幹事国	
参加国及び参加人数	7ヶ国、主な国名 日本(6)、ﾌﾗﾝｽ(2)、ﾄﾞｲﾂ(2)、中国(1)、ｵﾗﾝﾀﾞ(1)、米国(1)、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ(1)、参加人数（14）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA電子)] 横溝剛一(ﾙﾈｻｽ)、中村篤(ﾙﾈｻｽ)、○増田則夫(NEC)、○齊藤義行(松下)、三谷真一郎(日立)、市川浩司(ﾃﾞﾝｿｰ)		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。）

1. 前回（ワルシャワ会議）議事録の確認・各プロジェクトのステータス確認
議事録は修正無く承認された。ステータスについては IEC 62132-3（BCI 法）が遅れているが、それ以外は順調に進んでいることが確認された。
2. IEC 61967-6 Amendment（MP 法）
前回会議以降に出された US コメントと Observation について議論が行われた。主な議論のポイントは被測定導体とループプローブ中心との距離、レジスト厚、プローブ先端の寸法に関する点であった。最終的にレジストは図から削除すること、プローブの寸法に公差を入れることで対応し、FDIS に移行することとなった。
3. IEC 62132-3（BCI 法）
47A/752/RVC の各国コメントについて議論が行われた。コメント数が約 120 件と非常に多いため、Technical/General コメントに絞って議論を実施し、ほとんどのコメントが Accept された。修正項目が多いため、次のステージで 3CD/2CDV/FDIS のどれに移行するか意見が分かれたが、CDV の投票結果で賛成票が 67%を超えていることもあり、FDIS に移行することとなった。
4. IEC 62132-2（TEM Cell 法）
47A/759/CC のコメント（DE と JP）について議論が行われた。JP コメントおよび修正提案はすべて Accept された。現在の文書にまだ TBD が残っていることもあり、今回の修正を反映後、2cd CD に移行することとなった。
5. その他
5.1 多ピン LSI 用 Emission/Immunity 測定環境の提案（FR）
多ピン LSI に IEC 61967/62132 を適用する際の測定冶具の紹介があった（TR として NP 予定）。
5.2 IEC 62215-3 の提案（US）
Impulse immunity 測定法として DPI 法に似た測定法の紹介があった。Part3 としては既に EFT の提案（IT）が予定されており、調整が必要。
5.3 1GHz 以上への周波数拡張に向けて
・IEC 61967-4（VDE 法）に関して高周波まで対応できるよう Calibration 手法提案を行う予定（DE）
・IEC 61967-1/62132-1 に関してメンテナンス案を各国の NC に送付する（NL）
・IEC 62132-7 として LIHA を提案するとともに、評価用にアンテナを貸し出す（FR）
6. 次回予定　2007 年春：Turin（IT）：日程は未定、2007 年秋：Toulouse（FR）：11 月 5 日～9 日

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

IEC 活動推進委員会事務局：(社)電子情報技術産業協会 標準化センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（(三井住友海上別館ビル）　Tel:03-3518-6435　Fax:03-3295-8727

様式 4

（社）電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会　御中

運営委員会・資料番号：**159-3/SC47A-②**（事務局記入）

提出日：2006 年 10 月 30 日

（報告者記載）整理番号：H18SC47A④

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：中村 篤　報告書作成者氏名：市川 浩司　（会社名）（株）デンソー

出席会議名（半角）	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC47A/WG2（半角）
SC47A / WG2	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称（日本語）	集積回路／デジタル IC
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	□単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2006 年 10 月 23 日 ～ 2006 年 10 月 24 日		
開催場所	（国名）イギリス	（都市名）ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	三谷 真一郎	幹事国	
参加国及び参加人数	8ヶ国、主な国名 日本、ﾌﾗﾝｽ、ﾄﾞｲﾂ、中国、ｵﾗﾝﾀﾞ、米国、ﾎﾟｰﾗﾝﾄﾞ、ｲｷﾞﾘｽ、参加人数（16）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○三谷真一郎(日立製作所)、○市川浩司(デンソー)、斎藤義行(松下電器)、中村篤(ルネサステクノロジ)、増田則夫(日本電気)、横溝剛一(ルネサステクノロジ)		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。）

1. IEC60748-2-20 Ed.2 (Low voltage family spec.改訂、日本提案)

1.1 前回課題となったシュミットインプット閾値の周波数特性について、日本が実測データと回路動作の考察の両面からノーマルインプットと同じ周波数特性であることを説明した。各国委員の理解が得られて解決した。

1.2 47A/755/CD に対するコメントを審議。全コメントの observation 案を作成した。

1.3 審議結果に基き CC 文書の回覧を行ない、年内に CDV ドラフトを回覧することを決めた。

2. IEC62433 Ed.1 (ICEM: Models of Integrated Circuits for EMI behavioural simulation)

WG2 会議に先立つ SC47A Plenary で IEC62433 のシリーズ化案を説明し、SC47A としてシリーズ化を進めることとなった。現在の 62433（フランス提案）は 62433-2 となる見通し。以下、シリーズ化を前提に報告する。

2.1 IEC62433-1 (General、オランダ提案予定)

Mart Coenen 氏から NP 文書案が提示され、簡単な紹介があった。年内に NP 提案の見通し。

2.2 IEC62433-2 (Conducted emission、フランス提案)

2.2.1 2CD(47A/753/CD)に対して、4 カ国から膨大なコメント(合計 120)が提出されたため、General 及び Technical に絞って審議し Observation 案を決めた。Editorial については全て accepted となった。

2.2.2 フランス提案のモデル構造がモデルの再利用・ポータビリティに問題があるため、日本からモデル構造の変更を提案した。米国・オランダ委員等の賛同を得て多数意見を獲得でき、最終的にはフランスも同調せざるを得ず採用されることとなった。しかし、原案のモデル構造との併記までしか追い込めず、このままではモデルの意味について混乱を生じる可能性がある。このため、日本案を唯一のモデル構造とするべく引き続き働きかけていく必要がある。

2.2.3 パラメータ抽出法を Annex にするべきなど、重要な日本のコメントについても同意が得られた。

2.2.4 3CD が必要との意見が多数派であったが、フランス委員の強い要望から CDV に進むこととした。CDV の approval は微妙と思われる。日本としては CDV ドラフトの記述を充分に吟味して投票する。

2.3 IEC62433-3 (Direct emission、フランス提案予定)

フランス委員より IEC62433-2 で手一杯であり、今回は進展がないと報告された。

3 総括および次回会議予定

日本提案の IEC60748-2-20 が順調に進み、62433 のシリーズ化も見通しが立った。62433-2 は CDV に進むことにしたが、IS に相応しい内容になるよう、今後も充分なチェックが必要。次回は WG9 と同期し、2007 年 4 月に開催予定。

[注]: 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

IEC 活動推進委員会事務局:(社)電子情報技術産業協会 標準化センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11((三井住友海上別館ビル) Tel:03-3518-6435 Fax:03-3295-8727

（社）電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会　御中

運営委員会・資料番号：**159-3/SC47A-③**（事務局記入）

提出日：2006 年 11 月 9 日

（報告者記載）整理番号：H18SC47A⑤

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：中村 篤　報告書作成者氏名：春日壽夫　（会社名）NEC ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株)

出席会議名（半角）	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC47A（半角）
SC47A	□TC ☒SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称（日本語）	半導体／集積回路
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	□単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2006 年 10 月 23 日 ～ 2006 年 10 月 27 日		
開催場所	（国名）イギリス	（都市名）ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	Mr. Roger Goerge（英国）	幹事国　日本	
参加国及び参加人数	8ヶ国、主な国名 日本、ﾌﾗﾝｽ、ﾄﾞｲﾂ、中国、ｵﾗﾝﾀﾞ、米国、韓国、ｲｷﾞﾘｽ、参加人数（16）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者･･･（例）：○ 電子太郎（JEITA 電子）] ○横溝剛一（ルネサステクノロジ）、○春日壽夫（NEC エレクトロニクス／コンビナ）、 ○中村篤（ルネサステクノロジ）、三谷真一郎（日立製作所））		

議事概要（背景･目的･成果･問題点など）（この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。）

目的：半導体集積回路デバイスにかかわる標準化につき審議している。

成果：

1．IS 発行文書(前回会議以来、発行された IS が報告された：8 件)

(IS #)	(発行日)	開発期間	テーマ(WG)
1)IEC 60748-4-3 - Ed. 1.0 - English	2006-08-29	4y 2m(4)	ADC(WG4)
2)IEC 62132-4 - Ed. 1.0 - Bilingual	2006-02-27	4y 2m(4)	EMC(WG9)
3)IEC/TR 61967-4-am1 - Ed. 1.0 - Bilingual	2006-02-13	2y 3m(2)	EMC(WG9)
4)IEC 62132-1 - Ed. 1.0 - Bilingual	2006-01-19	4y 10m(5)	EMC(WG9)
5)IEC 62132-5 - Ed. 1.0 - Bilingual	2005-10-10	6y 5m(7)	EMC(WG9)
6)IEC 61967-2 - Ed. 1.0 - Bilingual	2005-09-29	3y 10m(4)	EMC(WG9)
7)IEC/TS 61967-3 - Ed. 1.0 - Bilingual	2005-06-10	3y 11m(4)	EMC(WG9)
8)IEC/TR 61967-4-1, Ed.1.0- English	2005-02-07	1y	EMC(WG9)

2．WG 活動状況：審議中の標準化提案

2-1)WG2： ロジックデジタル IC:I/O インターフェース等 （コンビナ：三谷）

①日本提案 2 件(リーダ：栗本[1CD]、三谷[APUB])

②フランス提案 1 件（ [2CD])

2-2) WG4： IC のインターフェース（コンビナ:英国)

①IEC60748-3：が IS になって完了

2-3) WG7: 先端ハイブリッド IC （コンビナ：春日）

①PWI として SiP を検討中(関連する TC91、TC47WG2、SC47D、TC40 等との合同活動が必要)

2-4) WG9：半導体 EMC 測定方法 in ICs （コンビナ：オランダ）

①日本提案 1 件（リーダ：日本　渡邊/増田[ADIS])　FDIS 送付(11/30)

②他国提案 8 件審議

3．その他

Edited CDV の取り扱い

・FDIS 文書は、Edited CDV を必ず使うことが最近の CO の指導であるが、規定上明確になっていないことから、混乱をしている。CO に対して、Edited CDV に関する規定を明確にする事、配布先を国際幹事だけではなく、WG コンビナ及び Pj リーダにも配布されることを出席の CO スタッフ（Dennis 氏）に強く要望した。

以上

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。

様式 4

（社）電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会　御中

運営委員会・資料番号：**159-3/SC47E-①**

提出日：2006 年 12 月 1 日

（報告者記載）整理番号：
H18SC47E①～⑥

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：赤羽根　克己　報告書作成者氏名：大芝　克幸　（会社名）ソニー(株)

出席会議名（半角）	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC47E, WG1,WG2,WG3,WG4 (半角)
SC47E	□TC ☒SC □TA □WG □PT □その他	名　称 (日本語)	個別半導体：半導体センサ、マイクロ波デバイス、パワーデバイス、フォトカプラー
WG1	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
WG2	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
WG3	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
WG4	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他	□単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2006 年 10 月 23 日 ～ 2006 年 10 月 27 日		
開催場所	（国名）イギリス	（都市名）ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	ﾁｪｱﾏﾝ:Madam Delort(仏) ｺﾝﾍﾞﾅ:WG1 Park(韓国), WG2 大和田(日), WG3 古賀(日), WG4 増田(日)	幹事国　韓国	
参加国及び参加人数	7ヶ国、主な国名 C.O.、英、仏、独、米、韓国、中国、日本、参加人数 (30)		
日本人出席者名 (会社名)	[○：補助対象者… (例)：○ 電子太郎(JEITA 電子)] 大和田邦樹(標準化工学研)、○樋口泰之(ローム)、○梅田章(産総研)、○大芝克幸(ソニー)、○古賀健司(日立)、 ○宮下秀仁(富士電機)、○由宇　義珍(三菱)、○増田(シャープ)、○小黒洋一(東芝)		

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。）

【背景・目的】各 WG の年間活動報告、各 PJ の文書審議と次のｽﾃｯﾌﾟの確認。ﾒｲﾝﾃﾅﾝｽと個別半導体共通課題の審議。

【成果・問題点】

[SC47E] (Plenary)

1. 各 WG ｺﾝﾋﾞﾅｰが昨年の東京会議以降 1 年間の活動状況と会期中の成果を報告。
2. Delort 委員長が任期満了で委員長を退任(2007 年 4 月)。
3. BDS(Blank Detail Specification)文書(12 規格)の廃止が提議された。
4. SMB 決定 127/13(SMB/3333/INF)で審議停止となった 60747-14-4 加速度ｾﾝｻｰ(WG1)については時間を割き、ISO/TC108 との問題解決に向け対応を決定。(WG1 参照)
5. 次回、2007/11/05-09 仏 Toulouse。

[WG1] 1. 60747-14-4：①TC47Lycoudes 議長が、「ISO の規格とは別に半導体加速度計の規格が必要」と方針を明示。
②ISO 宛の手紙を、IEC 中央事務局の Mr. Chew が担当・作成し送付。
③FDIS 最終案を早急に用意し、ISO/TC108 に 11 月末までに回答を寄せるように要請する。
④ISO/TC108 が反対を表明した時には、IEC 側の委員長と ISO 側の委員長が米国で会議を開催する。
⑤日本は、11/３までに正誤表を作成する。

2. 60747-14-1：CD 案を 12/31 までに提出。
3. 60747-14-3：CD 案を 11/30 までに提出。
4. 60747-14-5：NP 承認され投票ｺﾒﾝﾄを議論。11/30 までに CD 提出。
5. CMOS ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ NP(韓国提案)はｴｷｽﾊﾟｰﾄ不足で否決。 6. 次回、2007/5～7　中国または日本。

[WG2] 1. 60747-4 Ed. 2 FDIS 案：参照した 60747-1 が Ed. 2 に改訂され、RVC に追加修正が発生。修正案を承認し FDIS に進む。
2. 60747-16-1 Ed. 1 Am. 1 FDIS：日本が投票時にｺﾒﾝﾄした追加修正を承認。IS 発行へ進む。
3. 60747-16-2 Ed. 1 Am. 1 CDV：CD からの修正箇所を説明し了承。
4. 発振器規格 NP：ｴｷｽﾊﾟｰﾄ登録不足で否決されたが、再度 NP 提案。前回 NP へのｺﾒﾝﾄを議論し、中国提案の項目を追加し CD 案を提出する。中国にｴｷｽﾊﾟｰﾄ登録を再度要請した。
5. 60747-16-3, -4, -10：MCR 発行する。
6. 次回、2007/5～7　北京または東京。

【成果・問題点】（続き）

[WG3] 1. 60747-7 Ed.3 Bipolar transistors：昨年東京会議でﾄﾞｲﾂから提案された抵抗内蔵ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀについて議論。一旦、Ed.3 の Amendment とすることに決めたが、事務局 Mr.Chew の CD 案の中に入れるべきとのｺﾒﾝﾄに従う。抵抗内蔵ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀ部分はﾄﾞｲﾂが担当し、CD 案を 11 月初旬にｺﾝﾍﾞﾅに送付。今回出席した委員で確認し、異論がなければ CD 案として今年末に提出。

2. 60747-15Ed.2 Isolated power semiconductor device：11/初 MCR 提出。ｽｹｼﾞｭｰﾙは、CD:2006/12, CDV;2007/9, FDIS;2008/5, IS;2008/9。PL が事前に作成した CD 案を審議し、それに対する英、独、日のｺﾒﾝﾄ、特に英国のを参照し修正した。日本案、独案も考慮した CD 案を 11 中に PL が作成する。

3. 次回、2007/6 ニュルンベルグ。

[WG4] 1. 60747-5-5 Ed.1：SMB/3318/QP で 2ndFDIS の提出が承認され、1stFDIS への修正内容を確認。11/15 までに委員に回付する。SSR に関する用語と DynamicCMTI 測定法を Amendment として米国が NP 提案する。

2. 60745-1, -2, -3：MCR を発行する。

3. 独が MagneticCoupler の規格提案を紹介。

4. 次回、2007/3 シンガポール。

[注]: 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。

2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

IEC 活動推進委員会事務局:(社)電子情報技術産業協会 標準化センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11（三井住友海上別館ビル） Tel:03-3518-6435 Fax:03-3295-8727

(TSC-06 様式 2006.3)

様式 4

(社) 電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会 御中

運営委員会・資料番号： 159-3/SC62D① (事務局記入)

提出日: 2006 年 11 月 27 日

(報告者記載) 整理番号：H18SC62D③

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名： 内藤正章　報告書作成者氏名： 市川義人　(会社名) オリンパス (株)

出席会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC62D/MT16 (半角)
SC62D/MT16	□TC □SC □TA □WG □PT ☒その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称 (日本語)	医用光学機器 (内視鏡対応 G)
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	☒単独開催 □同時開催	
開催期日	2006 年 11 月 12 日 ～ 2006 年 11 月 15 日		
開催場所	(国名) ドイツ	(都市名) フランクフルト	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	M Marzinko／ R L Gray	幹事国 独	
参加国及び参加人数	4ヶ国、主な国名 独、英、日 参加人数 (5)		
日本人出席者名 (会社名)	[○：補欠候者… (例)：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○ 市川義人(オリンパス(株))		

議事概要 (背景・目的・成果・問題点など) (この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に対応しながら最大28行まで記入できます。)

1. 背景・目的

IEC 60601-1医用電気機器第3版の改定に伴い、個別規格及び副通則の改定が始まれている。第3版に適合するには個別規格、副通則にも適合しなければならないため、それぞれの規格の改定は急務な状態である。

2. 成果・問題点

・要求事項全項目の審議と付属書の審議(途中まで)終了した。2008年2月までにCDVの目標はぎりぎりクリアできそうである。

・IEC 60601-1第3版の基本性能が非常にわかりにくく且つ個別製品の特性で異なるため、基本的にはリスクマネージメントで決定すべきともめたが。例のみ3項目盛り込むことにした。

・耐電圧、漏れ電流試験は既にIEC 60601-2-2で規定しているため、避けられない。2-2を参照することにしたが、問題が無いか各社試験する(他社は問題が無いと言っていた)

・用語を一部変更(endoscopicaly-used accessoriesがenergized endotherapy deviceに変更)結果をMT17にも連絡する。

・接続部の漏れ電流試験を他の露出金属部にも適用することとした。(内視鏡、アクセサリー、HFの組み合わせでの漏れ電流測定法を独が強く提案したが、理論的にはできるが現実不可能で装置間の比較ができないと却下)

・IEC 60601-1の患者ケーブルの患者装着部と反対側にたいして、の要求事項の中にテストフィンガーで触れられてはならないという要求事項があり。これを適用するとライトガイドコネクター、CVのコネクタにも影響がでる。IEC 60601-2-2電気メス英 では除外しており、英国以外は反対したが次回に持ち越しになった。

・ユーザビリティー、警報及びIEC 60601-1-9環境保護規格、警報に関する対応の最終結論が出なかったため次回までに全員で考慮し対応案を作成してくることにになった。

3. 今後の予定

・2007年3月15日の週 最終CD案の完成のためのドイツ会議、2007年9月17日の週 CDV作成コメント審議(多分ドイツ)

・CD－2007年4月、 CDV－2008年1月、FDIS－2008年9月、IS-2008年11月

[注]: 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

IEC 活動推進委員会事務局:(社)電子情報技術産業協会 標準化センター

様式 4

(社) 電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会 御中

運営委員会・資料番号：159-3/SC62D② (事務局記入)

提出日：2006 年 11 月 28 日

(報告者記載) 整理番号： H18SC62D 予算無①

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名： 内藤正章　　報告書作成者氏名： 兵後充史　(会社名) 日本光電工業(株)

出席会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	SC62D/JWG7 (半角)
SC62D/JWG7	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☒その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	名称 (日本語)	自動式非観血血圧計
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	☒単独開催	☐同時開催
開催期日	2006 年 11 月 5 日 ～ 2006 年 11 月 8 日		
開催場所	(国名) キプロス	(都市名) リマソール	
チェアマン／コンベナ	Dr. S. Mieke/ D. Osborn	幹事国 ドイツ	
参加国及び参加人数	7 ヶ国、主な国名 アメリカ、ドイツ、フランス、オーストリア、スロベニア、日本、参加人数 (17)		
日本人出席者名 (会社名)	[○：補助対象者… (例)：○ 電子太郎(JEITA 電子)] 白崎俊(オムロンヘルスケア)、尾田欣士(松下電工)、○兵後充史(日本光電)		

議事概要 (背景・目的・成果・問題点など) (この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。)

ISO/TC121/SC3 と IEC/SC62D の Joint Working Group (JWG7)で、次の個別規格制定作業が進んでいる。

ISO IEC 80601-2-30 MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT –Part 2-30: Particular requirements for basic safety and essential performance of automated type non-invasive sphygmomanometers

今回の JWG7 の会議では、配布された WD2 に対し各国より寄せられたコメントについて討議し、CD 案をまとめた。

[討議内容と討議結果]

(1) 日本としては、以下 3 点を重要課題としてコメント発出するとともに、会議でも立場を主張した。

1)クリーニング、消毒、感染防止できることの要求：家庭用と公共用については、関係する苦情が極端に低いことを数値的に示した上で、構造上、対応が困難な上に大幅なコストアップとなるため、適用外とすべきと主張した。討議の結果、クリーニングについては方法を製造者が指定できることが確認できたため、適用することに同意した。

2)防水性の要求：以下理由により家庭用、公共用については防水性能を求めるべきではないと主張。a)家庭用や公共用血圧計で一般的なプリンタ付装置では用紙排出口からの水の侵入を防止できない。b)公共用に多い自動巻き付け式において、腕の挿入口の防水構造は実質不可能。c)家庭用では防水構造により 25～35％ものコストアップ。

病院向けでも防水性能は不要と意見もあるため、CD に質問形式で記載し、各国の意見を求めることになった。

3)単一故障時の過大圧防止手段に関する要求：別系統の圧検出システムなどを設けることは、家庭用や廉価な病院向け血圧計では非現実的なため、適用外とすべきとドイツが主張していた。討議の結果、a)患者が無意識であったり操作者の監視下にない状況があり得る自動繰り返し血圧計を除き、一般のカフを用いる機器については、過大圧発生時にカフまたは配管を外すことが可能なため、これを以って要求に準拠とする。b)自動巻き付け式については、腕が抜けない状況も予想されるため、機械式の非常スイッチ、または別系統の電気回路系による開放手段を備えることを要求する。

(2)討議結果を基に CD が作成され、IEC 文書 62D/585/CD として、11 月 24 日付で各国に回覧・配布された。
(コメント締切'07 年 3 月 2 日。)

(3)その他：臨床精度評価プロトコル(IEC ISO 81060-2)の WD 作成小グループの進捗が報告された。'07 年 4 月に WD を発行予定。尚、日本から提案している両側交互測定法の評価データ収集に 8 施設の協力が得られた。

(4) 次回 JWG 7 開催

自動式 CD(80601-2-30)コメント審議と CDV 案作成：'07 年 5 月 21～23 日　場所: ノーフォーク、アメリカ
臨床評価プロトコル規格 WD(81060-2)コメント審議と CD 案作成：'07 年 6 月 18~22 日　場所：ミラノ、イタリア
非自動式 DIS(81060-1)コメント審議と FDIS 案作成：'07 年 10 月　場所：スロベニア

[注]: 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。

様式 4

(社) 電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会 御中

運営委員会・資料番号： 159-3／TC91-① (事務局記入)

提出日：2006 年 11 月 15 日

(報告者記載) 整理番号：H18TC91①R

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：西山 和夫　報告書作成者氏名：土生 正　(会社名) 株式会社村田製作所

出席会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC91 (半角)
TC91/WG1	☐TC ☐SC ☐TA ☒WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	名称 (日本語)	電子実装技術
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	☐単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2006 年 10 月 24 日		
開催場所	(国名) 英国	(都市名) ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	W.Huck (コンベナ)	幹事国 日本	
参加国及び参加人数	5ヶ国、主な国名 ドイツ、英国、韓国、フィンランド、日本、参加人数 (16)		
日本人出席者名 (会社名)	[○：補助対象者… (例)：○ 電子太郎(JEITA 電子)] 苅谷義治(芝浦工大)、山本克己(テクノオフィスヤマモト)、高橋邦明(東芝)、気賀智也(ソニー)、○大島寛(ニチコン)、 ○土生正(村田製作所)、西山和夫(国際幹事)、小泉徹(国際副幹事)		

議事概要 (背景・目的・成果・問題点など) (この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。)

1.　目的・使命

日本提案の新規規格であるモジュールのGS (IEC 62421) 及びcomponent and packageのサンプリングプラン (IEC 61193-2) のCDVに対する各国からのコメントへの対応を審議し、observation付きRVC及びFDISの発行につなげる。

2.　審議概要

2.1　IEC 62421：モジュールのGS

CDVの投票結果は米国と英国が反対投票であったが、成立した。各国のコメントへの対応を事前に日本とコンビナ間で調整し、事前配布したobservation及びFDIS案を基にして審議が行われた。米国のコメントを考慮してビジネスモデルの図等に一部変更を加え、observation及びFDIS案が承認された。修正部分が多かったため、WG1メンバにメール配信し、再度確認をとった上で発行することとなった。尚、英国委員はこの規格の主旨を理解し賛同の意思を示した。

2.2　IEC 61193-2：component and packageのサンプリングプラン

CDVの投票結果は米国のみの反対投票で成立した。米国のコメントへの対応を事前に日本とコンビナ間で調整し、事前配布したobservation及びFDIS案を基にして審議が行われた。モジュールの適用範囲をM型ビジネスモデルに限定していたが、IEC61193-4が無い状況下では、ビジネスモデルを限定する記述は削除することとなった。WG1メンバにメール配信し、再度確認をとった上で発行することとなった。

2.3　IEC 61760-2：SMDの輸送保管条件

CDVに対する投票結果は全て賛成で修正意見が無かったため、ISに進む事が合意された。

2.4　New Business

リフローはんだ付けを行うTHMDsへの要求事項に関するNPをドイツが準備することの報告があり、このプロジェクトをドイツ，日本，英国，フィンランドがサポートすること、また、NPは関連部品のTCにも紹介することとなった。

2.5　WG1のスコープ変更

TC91:Electronics assembly technology - WG1: Requirements for Surface mount devicesからTC91:Electronics assembly technology - WG1: Requirements for Electronic Componentsに変更する事が合意され、Plenary meetingで承認を得ることとなった。

3．次回会議

TC91Plenary 会議の日程にあわせ 2007 年 10 月に韓国で開催する。

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。

(社) 電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会　御中

運営委員会・資料番号：159-3／TC91-②

様式 4

提出日：2006 年 11 月 10 日

(報告者記載) 整理番号：H18TC91②R

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：西山和夫　報告書作成者氏名：梅垣淳一　(会社名) 日本電気株式会社

会議名（半角）	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC91 (半角)
TC91WG2	☐TC ☐SC ☐TA ☒WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	名称 (日本語)	電子実装技術
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	☐単独開催	☒同時開催
開催期日	2006 年 10 月 24 日～2006 年 10 月 25 日		
開催場所	(国名)英国	(都市名)ロンドン	
チェアマン／コンベナ	D. Bergman (コンベナ代行)	幹事国　日本	
参加国	4ヶ国／主たる国名　日本、米国、ドイツ、スイス (計 13 名)		
日本出席者	[○:補助対象者…(例):○ 電子太郎(JEITA 電子)] 山本克己(テクノオフィスヤマモト)、○荒金秀幸(ソニー)、鶴田加一(溶接協会)、○梅垣淳一(NEC)、松村光弘(溶接協会)、本間仁(富士通)、于強(横浜国立大学)、柴田明一(JPCA)、西山和夫(国際幹事)、小泉徹(国際副幹事)		

議事概要 (背景・目的・成果・問題点など) (この欄は、見かけは 1 行ですが、所定欄に改行しながら最大 28 行まで記入できます。)

後任のコンビナを調整中のため、今回もバーグマンが代行した。「鉛フリー表示」等他のWGのプロジェクトも含めて議論した。既存のプロジェクトは最終段階に近づき、一方、日本からはボイド評価基準についての新規提案があった。

1)IEC 61192-5 :プリント板実装の修理とリワーク

・RVC(91/611/RVC)は発行されたが、FDIS が未発行となっている。審議はすでに済んでいるので、その場で、RVC に沿って FDIS 原稿を作成した。FDIS 原稿として提出する予定。

2)IEC 61190-1-3、-2:鉛フリーはんだ材料／ペースト(リーダ:鶴田)

・FDIS原稿は提出済みも発行が遅れている。正式に仏語訳を依頼して、間に合わなければ、11月にFDIS発行する。

3)ボイドの評価基準

・NP提案(91/639/NP)しているボイドの評価基準について、規格の紹介と実験評価結果の説明を行った。規格案のベースとなる実験評価結果を中心に質疑応答／コメントがあった。

・関連して、米国でのボイド評価についての取り組みについて、IPC-7095の改訂検討資料やソレクトロンからの提案資料をもとに、バーグマンから紹介があった。

・ボイド評価の重要性や評価方法／実験方法については理解が得られた。NPの投票締切りは2007年1月26日。

4)IEC 61189-5、-6 :プリント板実装／実装材料の試験方法

・IEC 61189-5、-6 いずれも FDIS 投票を経て IS が発行された。

・試験用基板作成用の設計データの表示について、付録で追加する案が紹介された。

5)鉛フリーの表示

・関連動向について情報交換した。中国提案の鉛フリー表示とECMA-370 2006 The ECO Declarationが紹介された。

6)サンプリングプラン

・サンプリングプラン(ボードとラミネート)(-3)については、エキスパートがそろいWG4で審議することになったとの報告があった。(-4)、(-5)について、WG1と協力していくとの報告があった。

7)IEC-61191s and 61192sのメンテナンス

・IEC-61191sと61192sのメンテナンスについて、次回の検討することになった。

8)次回会議

・(WG2)2007 年 6 月 7 日(木):シンガポール

・(TC91)2007 年 10 月 15 日(月)-19 日(金):韓国で仮設定し事務局で調整する。

[注]: 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。

(社) 電子情報技術産業協会　　運営委員会・資料番号：159-3／TC91-③　　様式 4

IEC 活動推進委員会　御中　　提出日：2006年11月8日

(報告者記載) 整理番号：H18TC91③R

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：西山和夫　報告書作成者氏名：春日壽夫　(会社名) NEC ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ(株)

会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC91WG3 (半角)
TC91WG3	□TC □SC □TA ☒WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称 (日本語)	電子実装技術/試験方法
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	□単独開催	☒同時開催
開催期日	2006年10月24日～2006年10月25日		
開催場所	(国名) 英国	(都市名) ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	春日壽夫(TC91WG3 コンビナ)	幹事国　日本	
参加国	7ヶ国／主たる国名　日本、韓国、米国、英国、ドイツ、オランダ、フィンランド (計25名)		
日本出席者	[○：補助対象者… (例)：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○于(横浜国大)、苅谷(芝浦工大)、大島(ニチコン)、高橋(東芝)、気賀(ソニー)、山本(ﾃｸﾉｵﾌｨｽ)、梅垣(NEC)、荒金(ソニー)、土生(村田 SS)、潮(PED)、柴田(JPCA)、西山(ソニー：TC91 国際幹事)、小泉 (JPCA:TC91 国際副幹事) 春日(NEC ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ：WG3 国際ｺﾝﾋﾞﾅ)		

議事概要 (背景・目的・成果・問題点など) (この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。)

目的：電子実装技術にかかわる実装後の試験方法につき審議している。

成果：

1. IS 発行文書(前回会議以来、発行された IS が報告された3件中日本提案1件)

1-1) IEC 61189-5-Ed.1.0- English : Test methods for printed board assemblies　2006-08-29

1-2) IEC 61189-6-Ed.1.0- English : Test methods for materials used in electronic assemblies　2006-07-24

1-3) IEC 60068-2-21-Ed.6.0- English (リーダ：梅垣)： Robustness of terminations and integral mounting devices 2006-06-22

2. 鉛フリーはんだに関する標準化提案 (日本担当：8件中5件リーダ、2件共同リーダ)

2-1) IEC/TR 60068-3-12 Ed.1(リーダ：ドイツ)：Method to evaluate a possible lead-free solder reflow temperature profile (タイトル変更 IEC/TR 60068-2-84) (91/601/DTR、91/636A/RVC) [APUB] TR を12月末。

2-2) IEC 60068-2-20(リーダ:ドイツ、共同リーダ/日本：大島)：リード付きデバイスのはんだ付け性とはんだ耐熱性試験 (91/602A/CC & 91/640/CDV が06-10-27に回覧された。) [CCDV] FDIS を4月末までに完成予定。

2-3) IEC 60068-2-69(リーダ：英国、共同リーダ／日本担当：大島)：SMD の Wetting balance はんだ付け性試験(91/562/CDV, 91/605A/RVC) [RDIS] FDIS 原稿をセクレタリを通じて CO に提出済み(8月、10月)。

2-4) IEC 60068-2-82 (リーダ：坂本)：ウィスカ試験方法(91/570/CDV, 91/606A/RVC:observations 付きが06-10-20に回覧された)　[ADIS]　FDIS 原稿を国際幹事へ11月末までに送付。

2-5) IEC 60068-2-83 (リーダ：大島)：SMD のはんだ付け性試験/ソルダペーストを用いる平衡法(91/584/RVN)　[ANW] CD 原稿を11月末までに送付。

IEC 62137-1(リーダ：高橋)：接合強度試験方法

2-6) part1(pull test：引っ張り試験)：(91/579/CDV, 91/630/RVC)　[ACDV] FDIS 原稿を11月末に送付。

2-7) part2(shear test：せん断試験)：91/580/CDV (91/631/RVC)　[ACDV] FDIS 原稿を11月末送付。

2-8) part3(cyclic drop test:落下試験)：91/614/CD　[1CD]　CDV を各メンバに12月末までに送付。

3. 新規提案の紹介 (日本提案2件の NP)

3-1)鉛フリー対応のロードマップ（荒金マップ）最新版を紹介した。
3-2) IEC 60068-2-ｘｘ（リーダ：戸井）：マイグレーション試験方法・NP 待ち。
3-3) IEC 62137-1-4, if approved)（リーダ：高橋）：繰り返し曲げ試験方法（91/637/NP）[PNW]
3-4) IEC 62137-1-5, if approved)（リーダ：苅谷）：せん断疲労試験方法　(91/638/NP)　[PNW]
・NP 文書は発行済みで投票締め切りは 2007 年 1 月。フィンランド、ドイツ、英国、米国からのエキスパート登録の確約を得た。

4．その他

4-1)62137 シリーズの番号再編成：2004 年 7 月に発行された IEC62137 Ed.1 の IEC 番号再編につき、2003 年 11 月、2004 年 9 月の TC91 会議で提案されていた件を再度確認した。
・62137-1（表面実装用）、62137-2(挿入実装用)とし 62137-3 として、既発行の 62137 を適用することとする。
4-2) **Edited CDV の取り扱い**
・FDIS 文書は、Edited CDV を必ず使うことが最近の CO の指導であるが、規定上明確になっていないことから、混乱をしており特にドイツメンバーから強い不満が出た。
・CO に対して、Edited CDV に関する規定を明確にする事、配布先を国際幹事だけではなく、WG コンビナ及び Pj リーダにも配布されることを出席の CO スタッフ（Dennis 氏）に強く要望した。

5．メンテナンスサイクル文書の確認

・メンテナンスサイクルの状況が確認された(IEC 60068-2-20、IEC 60068-2-21、IEC 60068-2-44、IEC 60068-2-54、IEC 60068-2-58、IEC 60068-2-69、IEC 60068-2-77)
5-1) IEC60068-2-20 改正(リーダ：ドイツ)： Pj で進行中（91/640/CDV が 06-10-27 に回覧された。）[CCDV]
5-2) IEC60068-2-44 改正(リーダ：ドイツ)：はんだ付け試験のガイダンス
・MCR を 11 月に発行し-3 シリーズとして全面改訂して審議する。
・並行して、MRD を 2009 に延長しておく。
5-3) IEC 60068-2-77 見直し(リーダ：土生)：MRD が 2006 であるので、至急見直しをする

6．次回会議

2007 年 6 月 7 日～8 日：シンガポール，TC91WG3 開催（JIC 第 8 回会議 6 月 4 日～6 日）
(Joint meeting of TC91WG3 and TC47WG2 の検討中)
2007 年 10 月 15 日～19 日：韓国 TC91 plenary meeting 計画中
11 月 5 日の週:フランス TC47 plenary meeting(joint meeting of TC91WG3 and TC47WG2 検討中)

〈予定〉IEC 総会に併せて、TC91 と TC47 と同期開催（招待されない場合、開催地は協力して決定する）
2008 年 秋（ブラジル）
2009 年 秋（イスラエル）
2010 年 秋 米国シアトル →TC47 と TC91 が招待される事は、ほぼ決定

以上

[注]: 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

IEC 活動推進委員会事務局:(社)電子情報技術産業協会　標準化センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11((三井住友海上別館ビル) Tel:03-3518-6435 Fax:03-3295-8727

(TSC-06 様式 2006.3)

様式 4

(社) 電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会 御中

運営委員会・資料番号: 159-3／TC91-④ (事務局記入)

提出日: 2006 年 11 月 14 日

(報告者記載) 整理番号: H18TC91④R

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名: 西山 和夫 報告書作成者氏名: 本間 仁 (会社名) 富士通株式会社

出席会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC91 (半角)
TC91 WG12	☐TC ☐SC ☐TA ☒WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	名称 (日本語)	電子実装技術
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	☐単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2006 年 10 月 23 日 ～ 2006 年 10 月 23 日		
開催場所	(国名) イギリス	(都市名) ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	D.Bergman(コンベナ)	幹事国 JAPAN	
参加国及び参加人数	5ヶ国、主な国名 ｱﾒﾘｶ、ｲｷﾞﾘｽ、ﾄﾞｲﾂ、ｽｲｽ、日本、参加人数 (計9名)		
日本人出席者名 (会社名)	[○: 補助対象者… (例): ○ 電子太郎(JEITA 電子)] 山本克己(ﾃｸﾉｵﾌｨｽﾔﾏﾓﾄ)、西山和夫(国際幹事)、柴田明一(JPCA)、○山内秀雄(ｿﾆｰ EMCS)、○本間仁(富士通)		

議事概要 (背景・目的・成果・問題点など) (この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。)

IEC61188 ｼﾘｰｽﾞの審議を行なった。

① IEC61188-7(Electronic component zero orientation for CAD library construction)の審議。
前回会議時に作成した文書内容の間違いや、追加・削除した方が良い文面、文章の構成等について討議と修正を行った。今回でようやく各国ｺﾒﾝﾄの追加と文書の整合が図れたため、正式国際標準の提案文書としてｾﾝﾄﾗﾙｵﾌｨｽに送る。この文書は提出期限の問題で1回ｷｬﾝｾﾙされ戻された経緯があるため、IEC 基準に準拠して文書内容に問題ないと判断した場合は、NP 提出後すぐに CDV まで持って行けるため、その処理を行う。

② IEC61188-5-3, 5-4, 5-5, 5-8 文書の進捗状況確認と審議
Secretary 経由で送った FDIS 文書の進捗状況を確認。現在、Central office の Editor が文章の校正中で、今回 IEC61188-5-3 文書の校正が終わり Secretary 送られてきているため、その校正内容について審議した。その結果、Editor の修正候補通りに変えていくことと、IEC61188-5-4, 5-5, 5-8 も類似している文書内容のため、これらに対しても同様に、Editor の指摘通りに変更して行く。修正した FDIS 文書は、Secretary 経由で Central office に送る。

③ IEC61188-5-1, 5-2, 5-6 ﾒﾝﾃﾅﾝｽ文書の審議
前回会議でｱﾒﾘｶ側の国際委員より IEC61188-5-1 文書のﾒﾝﾃﾅﾝｽ案が提示されたため、日本側国際委員で審議した結果を説明。日本側の討議内容・結果を事前に文書化し一つ一つの項目に対して拒否理由と改善案を示した。この結果、13 項目の反論に対して、5 項目の "Agree"、1 項目の "Disagree"、4 項目の討議による妥協案での終結と、3 項目の継続審議となり、ほぼ日本側提案を受け入れる形となった。今後、これらﾒﾝﾃﾅﾝｽ文書の修正検討と討議を行っていく。

④ その他審議
ｲｷﾞﾘｽ国際委員より基板ﾊﾟﾀｰﾝ間の絶縁試験用基板ｱｰﾄﾜｰｸ見本とその製造手段について追加したいとの提案があった。しかし、WG12 は設計基準関係で試験方法は対応できないことと、既に WG3 で同様の IEC61189-5 文書が作成されているため、この文書に Annex として入れてもらう方向とした。今後、WG3 に必要文書の追加審議を行ってもらう。

⑤ 次回開催場所
2007 年 5 月 31 日に JPCA ｼｮｰに合わせて日本で行う。

[注]: 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

様式 4

(社) 電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会 御中

運営委員会・資料番号： 159-3／TC91-⑤

提出日：2000 年 11 月 10 日

(報告者記載) 整理番号：H18TC91⑤R

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名： 西山和夫　報告書作成者氏名： 高橋邦明　(会社名) (株) 東芝

出席会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC91 (半角)
TC-91/WG3-TC47/WG2 Joint	□TC □SC □TA ☒WG □PT ☒その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名称 (日本語)	電子実装技術
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	□単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2006 年 10 月 26 日 ～ 2006 年 10 月 26 日		
開催場所	(国名) イギリス	(都市名) ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	D.Bergman(TC91)	幹事国 JAPAN	
参加国及び参加人数	7ヶ国、主な国名 米国、英国、ドイツ、フィンランド、韓国、日本、参加人数 (31)		
日本人出席者名 (会社名)	[○：補助対象者… (例)：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○高橋(東芝)、山本(テクノオフィス)、春日(NEC エレ)、梅垣(NEC)、大島(ニチコン)、土生(村田製作所)、荒金(ソニー)、○気賀(ソニー)、苅谷(芝浦工大)、于(横浜国大)、柴田(JPCA)、岩淵(JEITA)、西山(ソニー)、		

議事概要 (背景・目的・成果・問題点など) (この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。)

IEC/TC91 が策定する IEC 規格文書の審議として、TC91/WG3 と TC47/WG2 との Joint Meeting を集中して審議を行い、お互いに関連した規格について意見交換を行い、規格の整合と推進を図る。また全体を通じて規格文書の日本側意向の反映と日本からの規格文書の IEC 規格化への推進を図る。

●TC47WG2(半導体信頼性試験方法)と TC91WG3(電子実装試験方法)との合同会議

・7ヶ国 25 名 (TC91WG3:4ヶ国 22 名、TC47WG2：3ヶ国 3 名)

・活動紹介：2つのグループに関連の深いウィスカー試験、ドロップテスト、鉛フリー表示に活動状況報告と、新しいトピックスとして、繰り返し曲げ試験、せん断疲労試験、ボイド評価基準ついても紹介された。

1)TC47WG2 の Progress report London と TC91 の荒金マップの報告

2)トピックス

①落下試験

・TC47WG2：日本案(TC91 における日本案と同じ)についての進捗(CDV の配布状況)を、CO に確認する。

・TC91WG3:CDV 原稿出来次第、TC47WG2 の Jim Lynch 氏に送付する。(1 月中旬)

②ウィスカー試験

・TC47WG2：PAS を CO に送付しているが、文書の進捗を CO に問い合わせすることになっている。

・TC91WG3:Ohe 氏が FDIS 原案を紹介し、11 月に CO に送付予定であることを宣言した。

③鉛フリー表示

・TC47WG2：半導体に限定した鉛フリー表示規格を再提案することになっていたが、今回は提示されなかった。

3)新提案

①Cyclic bending test (IEC 62137-1-4, if approved)　[91/637/NP]・苅谷委員から技術紹介がなされた

②Mechanical shear fatigue test (IEC 62137-1-5, if approved) [91/638/NP]　・苅谷委員から技術紹介がなされた

③Evaluation criteria for voids in soldered joint of BGA　[91/639/NP]・于委員から技術紹介がなされた

6．次回会議　2007 年 6 月 7・8 日：シンガポール, Joint meeting of TC91WG3 and TC47WG2 は検討中

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。

様式 4

（社）電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会　御中

運営委員会・資料番号：159-3／TC91-⑥（事務局記入）

提出日：2006 年 11 月 13 日

（報告者記載）整理番号：H18TC91⑥R

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名：西山　和夫　報告書作成者氏名：潮　憲樹　（会社名）ﾊﾟﾅｿﾆｯｸ ｴﾚｸﾄﾛﾆｯｸﾃﾞﾊﾞｲｽ(株)

出席会議名（半角）	区　分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC91(半角)
TC91/WG1/62462, Ed.1	□TC □SC □TA □WG ☒PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	名　称 (日本語)	電子実装技術
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他		
	□TC □SC □TA □WG □PT □その他	□単独開催　☒同時開催	
開催期日	2006 年 10 月 26 日 ～ 2006 年 10 月 26 日		
開催場所	（国名）イギリス	（都市名）ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	PT Leader：潮　憲樹	幹事国　JAPAN	
参加国及び参加人数	3ヶ国、主な国名　フィンランド、ドイツ、日本、参加人数（12）		
日本人出席者名（会社名）	[○：補助対象者…（例）：○ 電子太郎(JEITA 電子)] ○潮(PED)、山本(テクノオフィス)、春日(NECエレ)、大島(ニチコン)、荒金(ソニー)、高橋(東芝)、土生(村田製作所)、岩淵(JEITA)，西山(ソニー)		

議事概要（背景・目的・成果・問題点など）（この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。）

IEC/TC91 が策定する「The marking for presence and absence of the specified chemical substance in materials, components and mounted used in electrical and electronic equipment」についての IEC 規格文書の審議として、Project Team Meeting (Project number IEC６２４６８、Ed.1）を開催し、91/612/CD についての各国よりのコメントについて集中して審議し、CDV の原案を作成した。

1．91/612/CD についてのコメント集計について

2006 年 7 月 14 日に公開され、10 月 20 日締め切りに対して、8 ヶ国（フィンランド、ベルギー、ドイツ、フランス、スペイン、イタリア、アメリカ、日本）から 31 個のコメントが寄せられた。

2．コメントに対する審議

コメント及び変更提案に対して、PT リーダーとしての意見を事前に準備し、個々の内容について CD の文案を修正した。

General に関しては 7 ヶ国より意見があった。米国より表示について戦略的に考慮（TC47 より半導体向けの表示について PAS 提案の予定だったが、今日現在動きが見られていない。）すべきとの意見だったが、代替案の提案なく反映しなかった。

日本及びドイツより RoHS の適用除外が増える中で、IEC 規格としての適用除外を残すのは不適当との意見があり、中国 RoHS では除外規定もないことから、特定有害化学物質の含有の有無の表示とすることとした。

フランス／ベルギー／ドイツより表示例は 1 種類とすべきとの意見であり、“＞　＜”で表示することへ一本化した。
非含有表示を G0（G　Zero）とすることとし、＞G0＜と表示することとした。
含有表示は順来の化学記号とし、事例として＞Pb＜とすることとした。
この中で、端子部に鉛が含有される場合は、＞PbT＜とし、接続の信頼性に対する注意喚起をすることとした。

3．ＣＤＶの作成と日程

ＰＴ会議での改訂案を、日本側で文章の整理をし、ＰＴメンバー回覧による校正の後、ＣＤＶ用規格として国際幹事へ提出することとした。

（11 月中に回覧、12 月中に国際幹事提出すれば、次回ＴＣ９１国際会議開催（2007 年 6 月）に平行審議可能。）

[注]：1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

様式 4

(社) 電子情報技術産業協会
IEC 活動推進委員会 御中

運営委員会・資料番号： 159-3／TC91-⑦

提出日: 2006年 11 月 14 日

(報告者記載) 整理番号：H18TC91⑦R

IEC 国際会議出席報告書

TC/SC/TA 担当委員名： 西山和夫　報告書作成者氏名： 西山和夫　(会社名) ソニー (株)

出席会議名(半角)	区分	組織番号 (TC/SC/TA)	TC91 (半角)
TC91 Plenary Mtg.	☒TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	名称 (日本語)	電子実装技術
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他		
	☐TC ☐SC ☐TA ☐WG ☐PT ☐その他	☐単独開催 ☒同時開催	
開催期日	2006 年 10 月 27 日 ～ 2006 年 10 月 27 日		
開催場所	(国名) イギリス	(都市名) ロンドン	
ﾁｪｱﾏﾝ／ｺﾝﾍﾞﾅ	D.Bergman (チェアマン)	幹事国 JAPAN	
参加国及び参加人数	7ヶ国、主な国名 米国、英国、ドイツ、フィンランド、韓国、中国、日本、参加人数 (31)		
日本人出席者名 (会社名)	[○：補助対象者… (例)：○電子太郎(JEITA電子)] ○多田先生(金沢工大:TC91 国内委員長)、○山本(テクノオフィス)、春日(NEC エレ:TC91/WG3 コンビナ)、梅垣(NEC)、高橋(東芝)、大島(ニチコン)、潮(パナソニック)、土生(村田製作所)、荒金(ソニー)、鶴田(千住金属)、気賀(ソニー)、池田(日立化成)、柴田(JPCA)、小泉(JPCA:TC91 国際副幹事)、岩淵(JEITA)、○西山(ソニー:TC91 国際幹事)、		

議事概要 (背景・目的・成果・問題点など) (この欄は、見かけは1行ですが、所定欄に改行しながら最大28行まで記入できます。)

年1回開催される IEC/TC91(Electronics Assembly Technology) Plenary Meeting が、TC91 各 WG 及び Project Mtg.と合わせてロンドンにて開催された。

議事概要は以下の通りである。

1．前回の TC91 Plenary Mtg.（フランクフルト開催）議事録の確認
・議長より昨年フランクフルトで開催された Plenary Meeting の議事録が報告され、承認された。

2．IEC Central Office からの連絡及び SMB 関連報告
・TC91 を担当する CO の Dennis Chew 氏より IEC 文書処理に関する Update 版の紹介があった
標準化処理手続きの迅速化に向けて 2nd CDV の投票期間が 2 ヶ月に短縮できる事、FDIS 原稿は CO によって編集された CDV(edited CDV)に基づく必要があることが報告された。
・Secretary より TC91 Chairman の任期の件について、幹事国として Bergman の意向を確認し、また SMB での投票の結果、来年の 5 月で切れる任期を 3 年延長した事を報告。

3．各 Working Group からの主な活動報告
3-1) WG1 (Requiements for Electronics components) convenor の Huck 氏より WG1 活動が報告された。
TC47 との関連も含めて、MEMS などの他のコンポーネントの実装技術領域についても WG1 でカバー出来るように、WG1 の Scope を Requirements for Surface mount devices から Electronics components に変更した事が報告され、承認された。
3-2) WG2 (Requiremenrs for Elecronics Assemblies) covenor 代理として Bergman 氏より WG2 活動と各文書の進捗を報告。
日本からの新しい提案として BGA 端子の void に関する評価法の提案を報告した。
3-3) WG3 (Measuring and Test Methods for Electronics Assemblies) convenor の春日氏より WG3 活動報告と、TC47/WG2 との Joint Mtg.の概要を報告した。
はんだ付け材料に関する規格、IEC61189-5 及び 61189-6 はともに IS 化され、次回のメンテナンスは 2010 年。
WG3 ではこの他に 10 件の Project を審議しており、各々の進捗を確認した。また日本からの新規提案である Cyclic bending test と mechanical shear fatigue test の報告があり、新規 Project として進める事となった。
・TC47/WG2 との Joint Mtg.では「Drop test」と「Tin Whisker」の規格化について共同で進めていく。
3-4) WG4 (Printed Board and Materials) convenor の D.Sober より現在の WG4 活動と文書の進捗が報告された。
WG4 では今後非常に多くの New Work を提案する事を検討している旨が報告された。
3-5) その他、WG5(Terms and Definitions)、WG10(Measuring and Test Methods for Printed Boards and Printed Boards

Materils)、WG12(Desgin of Printed Boards and Board Assemblies)、JWG11(PWB Electronic Data Description and Transfer)の活動について報告。審議が行われた。
また柴田 convenor より新規の JWG9(Optical functionally for electronics assemblies)活動について報告した。
詳細は割愛する。

4. TC91 SPS ならびに Programme works について確認し、SPS については P-member として Romania が加えられた。
5. 次回の IEC/TC91 Plenary 会議は 2007 年に韓国での開催を予定。日程は 10/22-23 に IEC General Mtg.が開催されるために別途調整する。尚、各 WG-Mtg.は 2007 年 6 月にシンガポールにて開催する事を確認した。

[注]: 1. 該当者は、出席会議終了後[6週間以内]に TC/SC/TA 担当委員経由で、IEC 活動推進委員会事務局宛ご提出下さい。
国際会議出席報告書の審議・承認の後に補助金を支払う。
会議終了後速やかに提出し、直近の運営委員会にて審議・承認を受けることが望ましい。
2. 本報告書は、同一会議に2名以上出席の場合、代表者が提出してください。
3. WG が TC/SC/TA と同時開催の場合は、WG 会議内容は TC/SC 報告に含めて報告書を提出して下さい。
4. 報告書の追加、訂正が生じた場合は、運営委員会開催後1週間以内に事務局に提出して下さい。
5. この報告書は、手続き完了後、JEITA ホームページ「IEC 活動推進委員会」に掲載し、会員企業への報告に替えます。

IEC 活動推進委員会事務局:(社)電子情報技術産業協会 標準化センター
〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 3-11((三井住友海上別館ビル) Tel:03-3518-6435 Fax:03-3295-8727

(TSC-06 様式 2006.3)